

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 1 部門第 2 区分
【発行日】 令和 6 年 8 月 28 日 (2024.8.28)

【公開番号】 特開 2024-79438 (P2024-79438A)
【公開日】 令和 6 年 6 月 11 日 (2024.6.11)
【年通号数】 公開公報 (特許) 2024-107
【出願番号】 特願 2022-192406 (P2022-192406)
【国際特許分類】
A 6 3 F 7/02 (2006.01)
【FI】
A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

10

【手続補正書】
【提出日】 令和 6 年 8 月 20 日 (2024.8.20)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】
【請求項 1】

複数の電子部品が実装される複数の基板を備える遊技機であって、
前記複数の基板は、
遊技の進行に関わる処理を実行する主制御手段を備える第 1 基板と、
該第 1 基板よりも前側に配置される第 2 基板と、を備え、
前記第 1 基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるとともに、該絶縁被膜上に複数の
前記電子部品それぞれを特定する表記部が形成され、
前記第 2 基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるものの、該絶縁被膜上に複数の前
記電子部品それぞれを特定する表記部は形成されず、
前記第 1 基板にはベタグランドパターンが形成され、前記第 2 基板にはベタグランドパ
ターンが形成されないものであり、
前記第 1 基板には、表面実装タイプの電子部品と、挿入実装タイプの電子部品と、が実
装されて、少なくとも前記挿入実装タイプの電子部品がハンダ付けされる複数の接続部の
うちの特定接続部と、前記ベタグランドパターンと、を接続する特定パターンが形成され
ており、
前記ベタグランドパターンは、前記第 1 基板の表基板面と裏基板面に形成されるととも
に、該ベタグランドパターン同士は、前記接続部に接続されたスルーホールにより電氣的
に接続され、少なくともいずれか一方の基板面の前記接続部は、前記特定パターンにより
前記ベタグランドパターンに接続される前記特定接続部である

30

40

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0007
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0007】

請求項 1 に係る発明によれば、
複数の電子部品が実装される複数の基板を備える遊技機であって、
前記複数の基板は、

50

遊技の進行に関わる処理を実行する主制御手段を備える第 1 基板と、

該第 1 基板よりも前側に配置される第 2 基板と、を備え、

前記第 1 基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるとともに、該絶縁被膜上に複数の前記電子部品それぞれを特定する表記部が形成され、

前記第 2 基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるものの、該絶縁被膜上に複数の前記電子部品それぞれを特定する表記部は形成されず、

前記第 1 基板にはベタグランドパターンが形成され、前記第 2 基板にはベタグランドパターンが形成されないものであり、

前記第 1 基板には、表面実装タイプの電子部品と、挿入実装タイプの電子部品と、が実装されて、少なくとも前記挿入実装タイプの電子部品がハンダ付けされる複数の接続部のうちの特定接続部と、前記ベタグランドパターンと、を接続する特定パターンが形成されており、

前記ベタグランドパターンは、前記第 1 基板の表基板面と裏基板面に形成されるとともに、該ベタグランドパターン同士は、前記接続部に接続されたスルーホールにより電氣的に接続され、少なくともいずれか一方の基板面の前記接続部は、前記特定パターンにより前記ベタグランドパターンに接続される前記特定接続部である

ことを特徴とする。

10

20

30

40

50